

P3718H

## **STMicroelectronics annonce une nouvelle famille de circuits pour décodeurs numériques HEVC haute définition d'entrée de gamme**

*Dotés d'une grande richesse fonctionnelle et commercialisés à un coût optimisé, ces nouveaux circuits architecturés autour de processeurs ARM® et adaptés aux décodeurs numériques HD HEVC connectés offrent des performances et des interfaces parées pour l'avenir*

Genève, le 9 septembre 2015 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour sa nouvelle famille de circuits HD HEVC Liege3 destinée au marché des décodeurs numériques d'entrée de gamme. Cette famille se compose de modèles destinés au marché du satellite (STiH337/STiH332), du câble (STiH372) et des décodeurs numériques IPTV (STiH307/STiH302).

Au-delà d'une simple mise à niveau des produits de génération précédente, cette nouvelle famille de produits associe les dernières architectures utilisées dans les produits Cannes de ST (STiH310/STiH312/318) à des blocs de propriété intellectuelle optimisés pour constituer des systèmes sur puce parés pour l'avenir et bénéficiant d'un haut niveau d'intégration. Cette famille de circuits facilitera la migration des décodeurs d'entrée de gamme vers le codage vidéo haute efficacité (HEVC).

Les nouveaux circuits pour décodeurs numériques de ST s'appuient sur une architecture matérielle et logicielle modulaire qui assure une grande flexibilité de configuration des plateformes, doublée d'un rapport optimum entre le coût et l'expérience des utilisateurs dans l'ensemble du segment d'entrée de gamme des décodeurs HD HEVC. Tous les circuits de cette nouvelle famille sont architecturés autour de processeurs ARM et disposent d'un brochage entièrement compatible, ce qui facilite la réutilisation des designs entre les différentes technologies de vidéodiffusion. De plus, la compatibilité logicielle avec la famille de systèmes sur puce Cannes de ST permet aux équipementiers de bénéficier du vaste écosystème existant pour faciliter la conception de boîtiers clients innovants pour un large éventail de middleware.

Destinés aux marchés des satellites, les systèmes sur puce STiH337/STiH332 implémentent un nouveau type de démodulation DVB-S2X, ce qui permet aux opérateurs multi-systèmes (MSO) de tirer parti des améliorations de compression et d'efficacité inhérents à la technologie HEVC. Cette approche améliore l'efficacité spectrale de la technique S2X et optimise les performances des transpondeurs satellitaires.

« Notre nouvelle famille de circuits architecturés autour de processeurs ARM renforce la présence de ST dans tous les segments du très dynamique marché des décodeurs HD HEVC d'entrée de gamme. Elle souligne par ailleurs notre engagement à proposer des solutions innovantes », a déclaré Philippe Notton, Group Vice President et Directeur général de la division Consumer Product de STMicroelectronics. « Avec la nouvelle famille de systèmes sur

*puce Liege3, les opérateurs multi-systèmes (MSO) peuvent maximiser le cycle de vie de leurs investissements HEVC avec une plateforme qui intègre une puissance de traitement suffisante pour faire face aux évolutions futures, tout en prenant en charge dès aujourd'hui les dernières interfaces et technologies de diffusion nécessaires à une utilisation optimale du spectre. »*

Les principales caractéristiques de la nouvelle famille de systèmes sur puce pour décodeurs numériques de ST, depuis les modèles d'entrée de gamme à 2 500 DMIPS sans processeur graphique jusqu'aux modèles à 5 000 DMIPS avec processeur graphique embarqué, sont les suivantes :

- Processeur ARM® capable d'exécuter plus de 5 000 DMIPS, pour une interface utilisateur avancée et des middlewares complexes.
- Processeur graphique Mali™ 400, pour une interface utilisateur parfaitement fluide et prise en charge du protocole HTML5 sur les plateformes connectées.
- Performances de codage vidéo haute efficacité (HEVC) 10 bits éprouvées lors de tests d'interopérabilité complets effectués avec tous les grands fabricants de codeurs.
- Jeu complet d'options de connectivité parées pour le futur : Ethernet, USB 3, PCIe, et HDMI.
- Démodulateur DVB-C ou DVB S2X intégré.
- Prise en charge d'une plage dynamique élevée (HDR).
- Moteur de sécurité avancé assurant la protection des contenus vidéo sécurisés pour l'accès à péage (CAS) et la gestion des droits numériques (DRM).
- Fabrication en technologie FD-SOI (*Fully Depleted Silicon on Insulator*) en 28 nm avec un haut niveau d'intégration des composants RF et analogiques et une efficacité énergétique exceptionnelle à tous les niveaux de fonctionnement, ce qui permet de réaliser des designs sans ventilateur très compacts.

La nouvelle famille de systèmes sur puce Liege3 est actuellement proposée aux grands clients sous la forme d'échantillons. Des démonstrations auront lieu dans la suite privée de ST, lors du salon [IBC 2015](#) qui a lieu du 11 au 15 septembre à Amsterdam.

#### **À propos de STMicroelectronics**

ST, un leader mondial sur le marché des semi-conducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au cœur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets. Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2014, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 7,40 milliards de dollars auprès de plus de 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : [www.st.com](http://www.st.com).

#### **Contacts presse :**

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06. 75.00.73.39

[nelly.dimey@st.com](mailto:nelly.dimey@st.com)

Alexis Breton

Tél : 01.58.07.78.62

Mobile : 06.59.16.79.08

[alexis.breton@st.com](mailto:alexis.breton@st.com)